# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-135008

(43)公開日 平成11年(1999)5月21日

(51	<b>۱</b> ۲	*	41 B
A D I	<i>)</i> ) ) T	11.1	4.

### 識別記号

# FΙ

H01J 9/02 B32B 7/06

H01J 9/02

B 3 2 B 7/06 F

# 審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 10 頁)

(21)	чш	30° 12
1/.1	,	 

(22)出願日

# 特願平9-311362

# 平成9年(1997)10月27日

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 小坂 陽三

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72)発明者 田中 浩之介

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

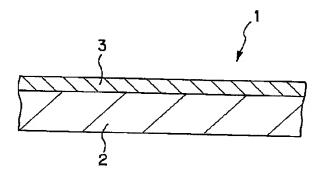
(74)代理人 弁理士 米田 潤三 (外1名)

## (54) 【発明の名称】 転写シート

# (57)【要約】

【課題】 プラズマディスプレイパネルの下地層、前面 板や背面板の誘電体層、感光性ブラックマトリックス層 および感光性リブ層を均一な層厚で高精度に形成可能な 転写シートを提供する。

【解決手段】 ガラスフリットを含む無機成分と、焼成 除去可能な有機成分とを少なくとも含有し、かつ、表面 光沢度が20~100の範囲内にある転写層をベースフ ィルム上に剥離可能に設けて転写シートとする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベースフィルムと、該ベースフィルム上 に剥離可能に設けられた転写層を少なくとも備え、該転 写層はガラスフリットを含む無機成分、焼成除去可能な 有機成分を少なくとも含有し、かつ、表面光沢度が20 ~110の範囲にあることを特徴とする転写シート。

【請求項2】 前記転写層上に剥離可能に保護フィルム を備え、該保護フィルムが剥離された状態での転写層の 表面光沢度が30~110の範囲にあることを特徴とす る請求項1に記載の転写シート。

【請求項3】 前記有機成分は感光性を有することを特 徴とする請求項1または請求項2に記載の転写シート。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプ レイパネルにおける誘電体層を簡便に形成するための転 写シートに関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、プラズマディスプレイパネル(P DP) における誘電体層の形成は、層厚やパターンの精 20 度を高いレベルで維持しながら、低い製造コストで実施 可能なことが要求されている。

【0003】従来、PDPにおける誘電体層の形成は、 所望の特性を有する誘電体層形成用のペーストを用いて スクリーン印刷やオフセット印刷等の印刷法により所定 のパターンを形成し、乾燥後に焼成してパターン形成す る印刷法等により行われていた。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の印刷法は、工程 が簡略であり製造コストの低減が期待されるが、スクリ ーン印刷法ではスクリーン印刷版を構成するメッシュ材 料の伸びによる印刷精度の限界があり、また、形成した パターンにメッシュ目が生じたりパターンのにじみが発 生し、パターンのエッジ精度が低いという問題がある。 また、オフセット印刷法では、印刷回数が進むにつれて パターン形成用ペーストが完全に基板に転写されずにブ ランケットに残るようになり、層厚やパターンの精度の 低下が生じる。したがって、ブランケットの交換を随時 行いペーストのブランケット残りを防止して誘電体層の 形成精度を維持する必要があり、このため作業が極めて 40 煩雑であるという問題があった。

【0005】本発明は、上述のような事情に鑑みてなさ れたものであり、プラズマディスプレイパネルの下地 層、前面板や背面板の誘電体層、感光性ブラックマトリ ックス層および感光性リブ層を高い精度で形成可能な転 写シートを提供することを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るために、本発明の転写シートは、ベースフィルムと、

なくとも備え、該転写層はガラスフリットを含む無機成 分、焼成除去可能な有機成分を少なくとも含有し、か つ、表面光沢度が20~110の範囲にあるような構成

【0007】また、本発明の転写シートは、前記転写層 上に剥離可能に保護フィルムを備え、該保護フィルムが 剥離された状態での転写層の表面光沢度が30~110 の範囲にあるような構成とした。

【0008】そして、上記の有機成分が感光性を有する 10 ような構成とした。

【0009】上記のような本発明において、転写層の表 面光沢度が20~110 (保護フィルムが剥離された転 写層の表面光沢度が30~110)の範囲内にあるとい うことは、無機成分の分散不良による凝集物やピンホー ル等の欠陥がなく転写層の表面平滑性が優れることであ り、このような転写層は、保護フィルムのラミネート時 において転写層と保護フィルムとの間に気泡が入り込む ことを防止し、転写時における被転写体への密着性に優 れ良好な転写性を有する。

#### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0011】図1は本発明の転写シートの一実施形態を 示す概略断面図である。図1において、転写シート1 は、ベースフィルム2と転写層3とを備える。転写層3 はベースフィルム2に対して剥離可能に設けられたもの であり、ガラスフリットを含む無機成分と焼成除去可能 な有機成分を少なくとも含有するとともに、表面光沢度 が20~110、好ましくは30~110、更に好まし 30 くは40~90の範囲内となるように設定されている。

【0012】また、図2は本発明の転写シートの他の実 施形態を示す概略断面図である。図2において、転写シ ート11は、ベースフィルム12と、このベースフィル ム12上に剥離可能に設けられた転写層13と、さら に、転写層13上に剥離可能に設けられた保護フィルム 14とを備える。転写層13は、ガラスフリットを含む 無機成分と焼成除去可能な有機成分を少なくとも含有す る。そして、転写層13は、保護フィルム14が剥離可 能に設けられる前の状態における表面光沢度と、保護フ イルム14が剥離された後の表面光沢度とが、30~1 10の範囲、好ましくは40~100の範囲内となるよ うに設定されている。

【0013】本発明の転写シート1、11は、上記のよ うに転写層の表面光沢度が20~110の範囲内にある ので表面平滑性に優れ、転写シート11では、保護フィ ルム14のラミネート時において転写層13と保護フィ ルム14との間に気泡が入り込むことが防止され、ま た、転写層3,13の被転写体への転写(転写シート1 1では保護フィルム14を剥離した後の被転写体への転 該ベースフィルム上に剥離可能に設けられた転写層を少 50 写)において密着性が向上して転写性が良好なものとな

【0014】本発明において転写層の表面光沢度は日本 電色工業(株)製グロスメーターVGS-1001DP を用いて測定した値であり、この表面光沢度を転写層 3,13の表面性の指標とするものである。すなわち、 転写層3,13に無機成分の分散不良による凝集物やピ ンホール等の欠陥がある場合、表面平滑性が低下し、そ れが表面光沢度に反映されて、表面光沢度が20未満と なる。また、通常、保護フィルム14が設けられた転写 転写層13との接触面の表面平滑性が悪い場合、保護フ ィルム14を剥離した状態での転写層13の表面平滑性 が低下し、それが表面光沢度に反映されて、表面光沢度 が30未満となる。したがって、転写層3の表面光沢度 を20以上、保護フィルム14を剥離した後の転写層1 3の表面光沢度を30以上とすることにより、表面性に 優れた転写層を備えた転写シートとすることができる。 このように、表面光沢度が高いほど転写層3,13の表 面性は良好なものとなるが、表面光沢度が110を超え ると、表面性向上による更なる効果が期待できずに製造 20 コストの増大、製造歩留の低下を来すことがあるので、 表面光沢度の上限は110程度が好ましい。

【0015】転写層3,13の表面光沢度は、後述する 無機成分の粉体形状や含有量、有機成分の種類や含有 量、使用する溶剤、塗布条件等により影響されるので、 表面光沢度が上記の範囲内に入るような条件を設定して 転写層3,13を形成する必要がある。

【0016】このような転写シート1,11は、シート 状、長尺状のいずれであってもよく、長尺状の場合はコ アに巻き回したロール形状とすることができる。使用す 30 るコアは、ごみ発生、紙粉発生を防止するためにABS 樹脂、塩化ビニル樹脂、ベークライト等で成形されたコ ア、樹脂を含浸させた紙管等が好ましい。

【0017】次に、上記の転写シート1,11の構成に ついて説明する。

#### <u>ベースフィルム</u>

本発明の転写シート1, 11を構成するベースフィルム 2,12は、転写層3,13を形成するときのインキ組 成物に対して安定であり、また、柔軟性を有し、かつ、 張力もしくは圧力で著しい変形を生じない材料を使用す 40

【0018】用いる材料としては、まず、樹脂フィルム を挙げることができる。樹脂フィルムの具体例として は、ポリエチレンフィルム、エチレン- 酢酸ビニル共重 合体フィルム、エチレン- ビニルアルコール共重合体フ ィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリスチレンフィル ム、ポリメタクリル酸エステルフィルム、ポリ塩化ビニ ルフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリビニ ルブチラールフィルム、ナイロンフィルム、ポリエーテ ルケトンフィルム、ポリフェニレンサルファイドフィル 50 上記のガラスフリットとしては、例えば、軟化温度が3

ム、ポリサルフォンフィルム、ポリエーテルサルフォン フィルム、ポリテトラフルオロエチレンーパーフルオロ アルキルビニルエーテルフィルム、ポリビニルフルオラ イドフィルム、テトラフルオロエチレンーエチレンフィ ルム、テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピ レンフィルム、ポリクロロトリフルオロエチレンフィル ム、ポリビニリデンフルオライドフィルム、ポリエチレ ンテレフタレートフィルム、1,4-ポリシクロヘキシ レンジメチレンテレフタレートフィルム、ポリエチレン 層13の表面平滑性は向上するが、保護フィルム14の 10 ナフタレートフィルム、ポリエステルフィルム、トリ酢 酸セルロースフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポ リウレタンフィルム、ポリイミドフィルム、ポリエーテ ルイミドフィルム、これらの樹脂材料にフィラーを配合 したフィルム、これらの樹脂材料を用いたフィルムを1 軸延伸もしくは2軸延伸したもの、これらの樹脂材料を 用いて流れ方向より幅方向の延伸倍率を高めた2軸延伸 フィルム、これらの樹脂材料を用いて幅方向より流れ方 向の延伸倍率を高めた2軸延伸フィルム、これらのフィ ルムのうちの同種または異種のフィルムを貼り合わせた もの、および、これらのフィルムに用いられる原料樹脂 から選ばれる同種または異種の樹脂を共押し出しするこ とによって作成される複合フィルム等を挙げることがで きる。また、上記の樹脂フィルムに処理を施したもの、 例えば、シリコン処理ポリエチレンテレフタレート、コ ロナ処理ポリエチレンテレフタレート、シリコン処理ポ リプロピレン、コロナ処理ポリプロピレン等を使用して もよい。

> 【0019】また、ベースフィルム2、12として金属 箔や金属鋼帯を用いることもできる。このような金属箔 や金属鋼帯の具体例として、銅箔、銅鋼帯、アルミニウ ム箔、アルミニウム鋼帯、SUS430、SUS30 1、SUS304、SUS420J2およびSUS63 1等のステンレス鋼帯、ベリリウム鋼帯等を挙げること ができる。さらに、上述の金属箔あるいは金属鋼帯を上 述の樹脂フィルムに貼り合わせたものを使用することも できる。

> 【0020】上記のようなベースフィルム2、12の厚 みは、 $4\sim400\mu$ m、好ましくは $10\sim150\mu$ mの 範囲で設定することができる。

転写層3,13は、ガラスフリットを含む無機成分と焼 成除去可能な有機成分を少なくとも含有するインキ組成 物を、ベースフィルム2、12上にダイレクトグラビア コーティング法、グラビアリバースコーティング法、リ バースロールコーティング法、スライドダイコーティン グ法、スリットダイコーティング法、コンマコーティン グ法、スリットリバースコーティング法等の公知の塗布 手段により塗布、乾燥して形成することができる。

# (1)無機成分

50~650℃であり、熱膨張係数α300 が60×10 <sup>-7</sup> ~100×10<sup>-7</sup> /℃であるガラスフリットを使用す ることができる。ガラスフリットの軟化温度が650℃ を超えると焼成温度を高くする必要があり、例えば、被 パターン形成体の耐熱性が低い場合には焼成段階で熱変 形を生じることになり好ましくない。また、ガラスフリ ットの軟化温度が350℃未満では、焼成により有機成 分が完全に分解、揮発して除去される前にガラスフリッ トが融着するため、空隙を生じやすく好ましくない。さ らに、ガラスフリットの熱膨張係数  $\alpha$  soo が  $6.0 \times 1.0$  10 ーメチルスチレン、Nービニルー2ーピロリドン等の1/℃未満、あるいは、100×10 / / ℃を超える と、被パターン形成体の熱膨張係数との差が大きくなり すぎる場合があり、歪み等を生じることになり好ましく ない。このようなガラスフリットの平均粒径は0.1~ 10μmの範囲が好ましい。このようなガラスフリット としては、例えばBi2O。またはPbOを主成分とす るガラスフリットを使用することができる。

【0021】また、転写層3,13は、無機粉体として 酸化アルミニウム、酸化硼素、シリカ、酸化チタン、酸 化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウ ム、酸化バリウム、炭酸カルシウム等の無機粉体をガラ スフリット100重量部に対して30重量部以下の範囲 で含有することができる。このような無機粉体は、平均 粒径が $0.1\sim20\mu$  mの範囲が好ましく、骨材として 焼成時のパターン流延防止の作用をなし、また、反射率 や誘電率を制御する作用をなすものである。

【0022】また、本発明の転写シート1,11を障壁 形成用として使用する場合、形成した障壁パターンの外 光反射を低減し、実用上のコントラストを向上させるた めに、無機粉体として耐火性の黒色顔料あるいは白色顔 30 料を転写層3,13に含有させることができる。耐火性 の黒色顔料としては、Co-Cr-Fe, Co-Mn-Fe, Co-Fe-Mn-Al, Co-Ni-Cr-Fe, Co-Ni-Mn-Cr-Fe, Co-Ni-Al-Cr-Fe, Co-Mn-Al-Cr-Fe-Si等 を挙げることができる。また、耐火性の白色顔料として は、酸化チタン、酸化アルミニウム、シリカ、炭酸カル シウム等が挙げられる。

#### (2) 有機成分

転写層3,13に含有される焼成除去可能な有機成分と 40 して、熱可塑性樹脂を使用することができる。

【0023】熱可塑性樹脂は、上述の無機成分のバイン ダとして、また、転写性の向上を目的として含有させる ものであり、例えば、メチルアクリレート、メチルメタ クリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレー ト、nープロピルアクリレート、nープロピルメタクリ レート、イソプロピルアクリレート、イソプロピルメタ クリレート、nーブチルアクリレート、nーブチルメタ クリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタ クリレート、tertーブチルアクリレート、tertーブチル 50 ーメチルスチレン、Nービニルー2ーピロリドンの1種

メタクリレート、nーペンチルアクリレート、nーペン チルメタクリレート、n-ヘキシルアクリレート、n-ヘキシルメタクリレート、2-エチルヘキシルアクリレ ート、2-エチルヘキシルメタクリレート、n-オクチ ルアクリレート、n-オクチルメタクリレート、n-デ シルアクリレート、nーデシルメタクリレート、2ーヒ ドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、 2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、スチレン、 $\alpha$ 種以上からなるポリマーまたはコポリマー、エチルセル ロース等のセルロース誘導体等が挙げられる。

【0024】特に、上記のなかでメチルアクリレート、 メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメ タクリレート、nープロピルアクリレート、nープロピ ルメタクリレート、イソプロピルアクリレート、イソプ ロピルメタクリレート、nーブチルアクリレート、nー ブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソ ブチルメタクリレート、tertーブチルアクリレート、te 20 rtーブチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルアク リレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、2-ヒドロキシプロ ピルメタクリレートの1種以上からなるポリマーまたは コポリマー、エチルセルロースが好ましい。

【0025】上記の熱可塑性樹脂の分子量は、10,0 00~500,000の範囲が好ましい。

【0026】また、転写層3,13に含有される焼成除 去可能な有機成分として、感光性樹脂組成物を使用する ことができる。

【0027】感光性樹脂組成物は、少なくともポリマ 一、モノマーおよび開始剤を含有するものであり、焼成 によって揮発、分解して、焼成後の膜中に炭化物を残存 させることのないものである。

【0028】ポリマーとしては、メチルアクリレート、 メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメ タクリレート、nープロピルアクリレート、nープロピ ルメタクリレート、イソプロピルアクリレート、イソプ ロピルメタクリレート、nーブチルアクリレート、nー ブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソ ブチルメタクリレート、tertーブチルアクリレート、te rtーブチルメタクリレート、nーペンチルアクリレー ト、n-ペンチルメタクリレート、n-ヘキシルアクリ レート、n-ヘキシルメタクリレート、2-エチルヘキ シルアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレー ト、n-オクチルアクリレート、n-オクチルメタクリ レート、nーデシルアクリレート、nーデシルメタクリ レート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエ チルメタクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレー ト、ヒドロキシプロピルメタクリレート、スチレン、α

以上と、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸の二量 体(例えば、東亜合成(株)製M-5600)、コハク 酸2-メタクリロイルオキシエチル、コハク酸2-アク リロイルオキシエチル、フタル酸2-メタクリロイルオ キシエチル、フタル酸2-アクリロイルオキシエチル、 ヘキサヒドロフタル酸2-メタクリロイルオキシエチ ル、ヘキサヒドロフタル酸2-アクリロイルオキシエチ ル、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、 ビニル酢酸、これらの酸無水物等の1種以上からなるポ ス誘導体等が挙げられる。

【0029】また、上記のコポリマーにグリシジル基ま たは水酸基を有するエチレン性不飽和化合物を付加させ たポリマー等が挙げられるが、これらに限定されるもの ではない。

【0030】上記のポリマーの分子量は、5,000~ 300,000、好ましくは30,000~150.0 00の範囲である。また、上記のポリマーに他のポリマ ー、例えば、メタクリル酸エステルポリマー、ポリビニ ルアルコール誘導体、N-メチル-2-ピロリドンポリ マー、セルロース誘導体、スチレンポリマー等を混合す ることができる。

【0031】感光性樹脂組成物を構成する反応性モノマ ーとしては、少なくとも1つの重合可能な炭素ー炭素不 飽和結合を有する化合物を用いることができる。具体的 には、アリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ブ トキシエチルアクリレート、ブトキシエチレングリコー ルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ジシク ロペンタニルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリ レート、グリセロールアクリレート、グリシジルアクリ 30 レート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒド ロキシプロピルアクリレート、イソボニルアクリレー ト、イソデキシルアクリレート、イソオクチルアクリレ ート、ラウリルアクリレート、2-メトキシエチルアク リレート、メトキシエチレングリコールアクリレート、 フェノキシエチルアクリレート、ステアリルアクリレー ト、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレング リコールジアクリレート、1,4ーブタンジオールジア クリレート、1,5-ペンタンジオールジアクリレー ト、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、1,3 40 ニループロパンジオンー2-(o-エトキシカルボニ ープロパンジオールアクリレート、1,4ーシクロヘキ サンジオールジアクリレート、2,2-ジメチロールプ ロパンジアクリレート、グリセロールジアクリレート、 トリプロピレングリコールジアクリレート、グリセロー ルトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアク リレート、ポリオキシエチル化トリメチロールプロパン トリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレ ート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、エチ レンオキサイド変性ペンタエリスリトールトリアクリレ ート、エチレンオキサイド変性ペンタエリスリトールテ 50 スイソブチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベン

トラアクリレート、プロピレンオキサイド変性ペンタエ リスリトールトリアクリレート、プロピレンオキサイド 変性ペンタエリスリトールテトラアクリレート、トリエ チレングリコールジアクリレート、ポリオキシプロピル トリメチロールプロパントリアクリレート、ブチレング リコールジアクリレート、1,2,4ーブタントリオー ルトリアクリレート、2,2,4-トリメチル-1,3 ーペンタンジオールジアクリレート、ジアリルフマレー ト、1,10-デカンジオールジメチルアクリレート、 リマーまたはコポリマー、カルボキシル基含有セルロー 10 ペンタエリスリトールヘキサアクリレート、および、上 記のアクリレートをメタクリレートに変えたもの、γー メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、1-ビニ ルー2ーピロリドン等が挙げられる。本発明では、上記 の反応性モノマーを1種または2種以上の混合物とし て、あるいは、その他の化合物との混合物として使用す ることができる。

> 【0032】感光性樹脂組成物を構成する光重合開始剤 としては、ベンゾフェノン、oーベンゾイル安息香酸メ チル、4,4ービス(ジメチルアミン)ベンゾフェノ ン、4,4ービス(ジエチルアミン)ベンゾフェノン、 αーアミノ・アセトフェノン、4, 4-ジクロロベンゾ フェノン、4ーベンゾイルー4ーメチルジフェニルケト ン、ジベンジルケトン、フルオレノン、2,2-ジエト キシアセトフォノン、2,2-ジメトキシー2-フェニ ルアセトフェノン、2ーヒドロキシー2ーメチルプロピ オフェノン、pーtertーブチルジクロロアセトフェノ ン、チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2-クロロチオキサントン、2-イソプロピルチオキサント ン、ジエチルチオキサントン、ベンジルジメチルケター ル、ベンジルメトキシエチルアセタール、ベンゾインメ チルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、アントラキ ノン、2-tertーブチルアントラキノン、2-アミルア ントラキノン、β-クロルアントラキノン、アントロ ン、ベンズアントロン、ジベンズスベロン、メチレンア ントロン、4ーアジドベンジルアセトフェノン、2.6 ービス (p-アジドベンジリデン) シクロヘキサン、 2, 6-ビス (p-アジドベンジリデン) -4-メチル シクロヘキサノン、2-フェニル-1, 2-ブタジオン -2-(o-メトキシカルボニル)オキシム、1-フェ ル) オキシム、1, 3-ジフェニループロパントリオン -2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、1-フェ ニルー3-エトキシープロパントリオン-2- (o-ベ ンゾイル) オキシム、ミヒラーケトン、2-メチルー [4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノー 1-プロパン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1 - (4ーモルフォリノフェニル)ーブタノンー1、ナフ タレンスルホニルクロライド、キノリンスルホニルクロ ライド、n-フェニルチオアクリドン、4,4-アゾビ

ズチアゾールジスルフィド、トリフェニルホスフィン、 カンファーキノン、四臭素化炭素、トリブロモフェニル スルホン、過酸化ベンゾイン、エオシン、メチレンブル 一等の光還元性の色素とアスコルビン酸、トリエタノー ルアミン等の還元剤の組み合わせ等が挙げられる。本発 明では、これらの光重合開始剤を1種または2種以上使 用することができる。

【0033】このような熱可塑性樹脂あるいは感光性樹 脂組成物の転写層3,13における含有量は、上述の無 機成分100重量部に対して3~50重量部、好ましく は5~30重量部の範囲で設定することができる。熱可 塑性樹脂や感光性樹脂組成物の含有量が3重量部未満で あると、転写層3,13の形状保持性が低く、特に、ロ ール状態での保存性、取扱性に問題を生じ、また、転写 シート1, 11を所望の形状に切断 (スリット) する場 合に無機成分がごみとして発生し、プラズマディスプレ イパネル作製に支障を来すことがある。一方、熱可塑性 樹脂や感光性樹脂組成物の含有量が50重量部を超える と、焼成により有機成分を完全に除去することができ ず、焼成後の膜中に炭化物が残り品質が低下するので好 20 ましくない。

【0034】さらに、上述の熱可塑性樹脂、感光性樹脂 組成物には、添加剤として、増感剤、重合停止剤、連鎖 移動剤、レベリング剤、分散剤、転写性付与剤、安定 剤、消泡剤、増粘剤、沈殿防止剤、剥離剤等を必要に応 じて含有することができる。

【0035】転写性付与剤は、転写性、インキ組成物の 流動性を向上させることを目的として添加され、例え ば、ジメチルフタレート、ジブチルフタレート、ジーn ーオクチルフタレート等のノルマルアルキルフタレート 類、ジー2ーエチルヘキシルフタレート、ジイソデシル フタレート、ブチルベンジルフタレート、ジイソノニル フタレート、エチルフタリルエチルグリコレート、ブチ ルフタリルブチルグリコレート等のフタル酸エステル 類、トリー2ーエチルヘキシルトリメリテート、トリー n-アルキルトリメリテート、トリイソノニルトリメリ テート、トリイソデシルトリメリテート等のトリメリッ ト酸エステル、ジメチルアジペート、ジブチルアジペー ト、ジー2-エチルヘキシルアジペート、ジイソデシル ーエチルヘキシルアゼテート、ジメチルセバケート、ジ ブチルセバケート、ジー2-エチルヘキシルセバケー ト、ジ-2-エチルヘキシルマレート、アセチルートリ (2-エチルヘキシル)シトレート、アセチルートリ -n-ブチルシトレート、アセチルトリブチルシトレー ト等の脂肪族二塩基酸エステル類、ポリエチレングリコ ールベンゾエート、トリエチレングリコールージー(2 -エチルヘキソエート)、ポリグリコールエーテル等の グリコール誘導体、グリセロールトリアセテート、グリ

体、セバシン酸、アジピン酸、アゼライン酸、フタル酸 等からなるポリエステル系、分子量300~3000の 低分子量ポリエーテル、同低分子量ポリーαースチレ ン、同低分子量ポリスチレン、トリメチルホスフェー ト、トリエチルホスフェート、トリブチルホスフェー ト、トリー2ーエチルヘキシルホスフェート、トリブト キシエチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、 トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェー ト、クレジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフ ェニルホスフェート、2-エチルヘキシルジフェニルホ スフェート等の正リン酸エステル類、メチルアセチルリ シノレート等のリシノール酸エステル類、ポリー1、3 ーブタンジオールアジペート、エポキシ化大豆油等のポ リエステル・エポキシ化エステル類、グリセリントリア セテート、2-エチルヘキシルアセテート等の酢酸エス テル類を挙げることができる。

10

【0036】また、分散剤、沈降防止剤は、上記の無機 粉体の分散性、沈降防止性の向上を目的とするものであ り、例えば、リン酸エステル系、シリコーン系、ひまし 油エステル系、各種界面活性剤等が挙げられ、消泡剤と しては、例えば、シリコーン系、アクリル系、各種界面 活性剤等が挙げられ、剥離剤としては、例えば、シリコ ーン系、フッ素油系、パラフィン系、脂肪酸系、脂肪酸 エステル系、ひまし油系、ワックス系、コンパウンドタ イプ等が挙げられ、レベリング剤としては、例えば、フ ッ素系、シリコーン系、各種界面活性剤等が挙げられ、 それぞれ適量添加することができる。

【0037】また、転写層3,13形成のために熱可塑 性樹脂あるいは感光性樹脂組成物とともに用いる溶剤と しては、例えば、メタノール、エタノール、nープロパ ノール、イソプロパノール、エチレングリコール、プロ ピレングリコール等のアルコール類、α-もしくはβ-テルピネオール等のテルペン類等、アセトン、メチルエ チルケトン、シクロヘキサノン、N-メチル-2-ピロ リドン、ジエチルケトン、2-ヘプタノン、4-ヘプタ ノン等のケトン類、トルエン、キシレン、テトラメチル ベンゼン等の芳香族炭化水素類、セロソルブ、メチルセ ロソルブ、エチルセロソルブ、カルビトール、メチルカ ルビトール、エチルカルビトール、ブチルカルビトー アジペート、ジブチルジグリコールアジペート、ジー2 40 ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリ コールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモ ノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチル エーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル 等のグリコールエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、 セロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、 ブチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテー ト、エチルカルビトールアセテート、ブチルカルビトー ルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテ セロールジアセチルモノラウレート等のグリセリン誘導 50 ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテ

定することができる。

ルアセテート、2ーメトキシエチルアセテート、シクロ ヘキシルアセテート、2ーエトキシエチルアセテート、 3ーメトキシブチルアセテート等の酢酸エステル類、ジ エチレングリコールジアルキルエーテル、ジプロピレン グリコールジアルキルエーテル、3ーエトキシプロピオ ン酸エチル、安息香酸メチル、N, Nージメチルアセト アミド、N, Nージメチルホルムアミド等が挙げられ る。

11

#### 保護フィルム

本発明の転写シート11を構成する保護フィルム14 は、保護フィルム14剥離後の転写層13の表面光沢度 を30~110の範囲から逸脱させることのない表面性 を有し、柔軟で、張力もしくは圧力で著しい変形を生じ ない材料を使用することができる。具体的には、ポリエ チレンフィルム、エチレンー酢酸ビニル共重合体フィル ム、エチレンービニルアルコール共重合体フィルム、ポ リプロピレンフィルム、ポリスチレンフィルム、ポリメ タクリル酸フィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリビ ニルアルコールフィルム、ポリビニルブチラールフィル ム、ナイロンフィルム、ポリエーテルエーテルケトンフ ィルム、ポリサルフォンフィルム、ポリエーテルサルフ オンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンーパーフル オロアルキルビニルエーテルフィルム、ポリビニルフル オライドフィルム、テトラフルオロエチレンーエチレン フィルム、テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプ ロピレンフィルム、ポリクロロトリフルオロエチレンフ ィルム、ポリビニリデンフルオライドフィルム、ポリエ チレンテレフタレートフィルム、ポリエチレンナフタレ ートフィルム、ポリエステルフィルム、トリ酢酸セルロ ースフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリウレタ ンフィルム、ポリイミドフィルム、ポリエーテルイミド フィルム、これらの樹脂材料にフィラーを配合したフィ ルム、これらの樹脂材料を用いたフィルムを1軸延伸も しくは2軸延伸したもの、これらの樹脂材料を用いて流 れ方向より幅方向の延伸倍率を高めた2軸延伸フィル ム、これらの樹脂材料を用いて幅方向より流れ方向の延 伸倍率を高めた2軸延伸フィルム、これらのフィルムの うちの同種または異種のフィルムを貼り合わせたもの、 および、これらのフィルムに用いられる原料樹脂から選 ばれる同種または異種の樹脂を共押し出しすることによ 40 って作成される複合フィルム等を挙げることができる。 これらのフィルムのうちで、特に2軸延伸ポリエステル フィルムを使用することが好ましい。また、上記の樹脂 フィルムに処理を施したもの、例えば、シリコン処理ポ リエチレンテレフタレート、コロナ処理ポリエチレンテ レフタレート、メラミン処理ポリエチレンテレフタレー ト、コロナ処理ポリエチレン、コロナ処理ポリプロピレ ン、シリコン処理ポリプロピレン等を使用してもよい。 【0038】上記のような保護フィルム14の厚みは、 4~400 μm、好ましくは6~150 μmの範囲で設 50 【0039】次に、上述のような本発明の転写シードを 用いたプラズマディスプレイパネル (PDP) の誘電体 層の形成の例を説明する。

12

【0040】ここで、誘電体層の形成を説明する前に、 AC型のPDPについて説明する。

【0041】図3はAC型PDPを示す概略構成図であ り、前面板と背面板を離した状態を示したものである。 図3において、PDP51は前面板61と背面板71と 10 が互いに平行に、かつ対向して配設されており、背面板 71の前面側には、立設するように障壁76が形成さ れ、この障壁76によって前面板61と背面板71とが 一定間隔で保持される。前面板61は、前面ガラス基板 62を有し、この前面ガラス基板62の背面側に透明電 極である維持電極63と金属電極であるバス電極64と からなる複合電極が互いに平行に形成され、これを覆っ て誘電体層65が形成されており、さらにその上にMg O層66が形成されている。また、背面板71は、背面 ガラス基板72を有し、この背面ガラス基板72の前面 側には下地層73を介して上記複合電極と直交するよう に障壁76の間に位置してアドレス電極74が互いに平 行に形成され、また、これを覆って誘電体層75が形成 されており、さらに障壁76の壁面とセルの底面を覆う ようにして蛍光体層77が設けられている。このAC型 PDPでは、前面ガラス基板62上の複合電極間に交流 電源から所定の電圧を印加して電場を形成することによ り、前面ガラス基板62と背面ガラス基板72と障壁7 6とで区画される表示要素としての各セル内で放電が行 われる。そして、この放電により生じる紫外線により蛍 光体層77が発光させられ、前面ガラス基板62を透過 してくるこの光を観察者が視認するようになっている。 【0042】次に、上述のPDPの背面板71における 誘電体層75の形成を説明する。

【0043】図4は本発明の転写シート1を用いた誘電体層75の形成を説明するための工程図である。

【0044】図4において、まず、下地層73上にアドレス電極パターン74が設けられた背面ガラス基板72に転写シート1の転写層3側を圧着し、その後、ベースフィルム2を剥離して転写層3を転写する(図4

(A))。この転写工程では、転写シート1の転写層3の表面光沢度が20~110の範囲内にあるので、転写層3の転写面側の表面平滑性は優れたものであり、下地層73およびアドレス電極パターン74への密着性が高く、転写層3の良好な転写が行える。尚、転写層3の転写において加熱が必要な場合、背面ガラス基板72の加熱、圧着ロール等により加熱を行ってもよい。

【0045】その後、焼成してパターン3 ´の有機成分を除去することにより、誘電体層75を形成する(図4(D))。

【0046】上述の例では、図1に示されるような本発

14

13

明の転写シートが使用されているが、図2に示されるような保護フィルムを備えた転写シートを使用する場合、保護フィルムを剥離除去した後に図4と同様の操作により誘電体層の形成を行うことが可能である。また、誘電体層75を所望のパターンで形成せずに全ベタで形成する場合は、転写層を転写した後、直ちに有機成分を焼成除去することができる。

\* [0047]

【実施例】次に、実施例を示して本発明を更に詳細に説明する。

【0048】まず、下記組成の誘電体形成用のインキ組成物を調製した。

[0049]

#### インキ組成物の組成

・ガラスフリット

· 70 重量部

(主成分: B i 2 O<sub>3</sub> , Z n O, B<sub>2</sub> O<sub>3</sub> (無アルカリ) 平均粒径=3 μ m)

· T i O2

7 重量部

· A 1 2 O3

5 重量部

(上記の無機成分混合体の軟化点=570℃、Tg=485℃ 熱膨張係数 α 200 = 80×10<sup>-7</sup> /℃)

・nーブチルメタクリレート/2ーヒドロキシエチル メタクリレート共重合体(8/2(モル比))

メタクリレート共重合体(8/2(モル比)) … 20重量部 (分子量=300,000)

・アジピン酸エステル系の転写性付与剤

12重量部

(旭電化工業(株)製アデカカイザーRS107)

・プロピレングリコールモノメチルエーテル

50重量部

次に、ベースフィルムとしてポリエチレンテレフタレートフィルム(東レ(株)製T-60)を準備し、このベースフィルム上に上記のインキ組成物をブレードコート法により塗布し乾燥(100  $\mathbb{C}$ 、2分間)して厚み25  $\mu$  mの転写層を形成した。

【0050】次に、この転写層に保護フィルムとしてシ リコン処理ポリエチレンテレフタレートフィルム(東セ ロ (株) 製SP-PET-03-25-C (厚み25 $\mu$ m))をラミネートして、図2に示されるような転写シ ート (試料1)を形成した。

【0051】また、上記のインキ組成物の分散条件を種々変えてインキ組成物を調製し、このインキ組成物を使用して上記と同様にして転写シート(試料2~5)を作製した。特に、試料4および試料5は、故意に分散不良を生じさせたインキ組成物を使用して作製した。

【0052】このように作製した各転写シート(試料1~5)について、保護フィルムをラミネートする前の転写層の表面光沢度をグロスメーター(日本電色工業

(株)製VGS-1001DP)で測定し、また、保護 40フィルムをラミネートした状態での気泡の混入の有無を

観察して、これらの結果を下記の表1に示した。

【0053】次いで、上記の各転写シート(試料1~5)を所定の幅にスリットし、ABS樹脂製のコアに巻き回し、ロール状態で25℃の条件で7日間保存した。その後、保護フィルムを剥離して転写層の表面光沢度を上記と同様に測定し、結果を下記の表1に示した。

【0054】また、上記の保存後の転写シートの保護フィルムを剥離し、100℃に加温したガラス基板(電極パターンが既に形成されたもの)上にオートカットラミネータを用いて40℃の熱ロールで圧着した。次に、室温まで冷却した後、ベースフィルムを剥離して転写層をガラス基板に転写した。この転写工程における各転写シート(試料1~5)の転写性を観察し、結果を下記の表1に示した。

【0055】次に、ガラス基板を570℃で焼成して誘電体層を形成した。

【0056】このように形成された誘電体層の厚みを測定し、また、表面状態を観察して下記の表1に示した。

[0057]

【表1】

16

表面光沢度転写シート		- 気泡の有無	転写性	誘電体層の厚み	誘電体層の	
松子ノート	保護フィルムラミネート前	剥離後	<b>双心の行無</b>	<b>拟子丘</b>	成単件間の序の (μm)	表面状態
武料1 試料2 試料3	8 7 6 3 2 3	1 0 3 7 6 4 0	な し な し な し	良好 良好 良好	2 0 2 0 2 0	良好 良好 良好
試料4 試料5	15 4.8	3 4 ラミ不可	あ り ラミ不可	密着不良発生 転写せず	20	マット状 

表1に示されるように、本発明の転写シート (試料1~ 3) は、転写層と保護フィルムとの間に気泡の混入がな く、ガラス基板への転写性も良好であった。また、これ らの転写シートを用いて形成した誘電体層は、厚みが均 一で表面の平坦性も良好であることが確認された。

【0058】これに対して、保護フィルムをラミネート する前の転写層の表面光沢度が20に達していない転写 シート(試料4)では、転写層と保護フィルムとの間に 気泡の混入がみられ、また、ガラス基板への転写性も、 転写層の膜切れやガラス基板との密着不良等が発生して 悪いものであった。さらに、この転写シート(試料4) を用いて形成した誘電体層は、焼成後も同様に基板との 密着不良が発生し、エアーの混入が認められた。また、 試料5では、保護フィルムとラミネートすることができ ず、ガラス基板へも転写できなかった。

#### [0059]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によればべ ースフィルム上に、ガラスフリットを含む無機成分と、 焼成除去可能な有機成分とを少なくとも含有し、かつ、 40 1,11…転写シート 表面光沢度が20~110(保護フィルムが剥離された 転写層の表面光沢度が30~110)の範囲内にある転 写層を剥離可能に設けて転写シートとするので、転写層 は無機成分の分散不良による凝集物やピンホール等の欠

陥がなく表面平滑性に優れ、保護フィルムを備える場合 には転写層と保護フィルムとの間に気泡が入り込むこと がないので転写層の良好な表面平滑性が保たれ、被転写 体への転写層の転写性が良好なものとなり、層厚の均一 な誘電体層の形成が可能となり、また、有機成分が感光 性を有する場合には、露光・現像によるパターニングの 精度が高く、これにより、誘電体の高精細なパターン形 成が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の転写シートの一実施形態を示す概略断 面図である。

【図2】本発明の転写シートの他の実施形態を示す概略 断面図である。

【図3】プラズマディスプレイパネルの一例を示す概略 構成図である。

【図4】本発明の転写シートを用いた誘電体層形成の一 例を説明するための工程図である。

#### 【符号の説明】

- - 2, 12…ベースフィルム
  - 3, 13…転写層
  - 14…保護フィルム
  - M…フォトマスク

